



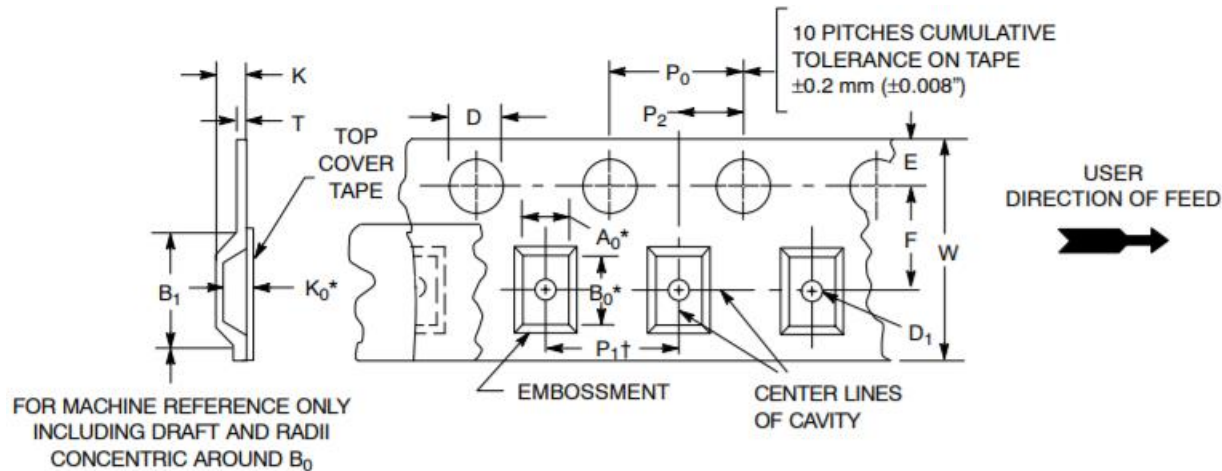
Title of Change:	Change in carrier tape design for ASEKS SOIC8L Devices.
Effective date:	25 Oct 2019
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Marquita.Jones@onsemi.com
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.
Change Category:	Test Change
Change Sub-Category(s):	Shipping/Packaging/Marking

Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
None	ASEKS, China

Description and Purpose:

The purpose of the new design is to minimize the movement of the devices inside the pockets of the reel. A Rib (fence) was provided in the pocket to suppress movement of the device. There are no changes to the vendor and there are no changes to the final reel quantities and packing specifications.



Material to be Changed	Before Change Description	After Change Description
A0 Dimension K0 Dimension K1 Dimension	6.9mm 2.0mm 1.7mm	6.55mm 2.1mm 1.8mm
Carrier Tape Design		

**List of Affected Standard Parts:**

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [**PCN Customized Portal**](#).

LM258DR2G	LM2903DR2G	LM2903VDR2G
LM2904DR2G	LM2904VDR2G	LM293DR2G
UC3843BD1R2G	UC3843BD1G	UC3842BVD1R2G
UC3842BVD1G	UC3842BD1R2G	UC3842BD1G
UC2845BD1R2G	UC2845BD1G	UC2844BD1R2G
UC2843BD1R2G	UC2843BD1G	UC2842BD1R2G
UC2842BD1G	NCP1608BDR2G	NCP1607BDR2G
NCP1252EDR2G	NCP1252DDR2G	NCP1252CDR2G
NCP1252BDR2G	NCP1252ADR2G	NCL30000DR2G
LM393DR2G	LM358DR2G	NCP1611BDR2G
NCP1611ADR2G	NCP4303ADR2G	NCP1653DR2G
NCP1653ADR2G	NCP1230D65R2G	NCP1230D133R2G
NCP1230D100R2G	NCP1207ADR2G	NCP4304BDR2G
NCP4304ADR2G	NCP1380DDR2G	NCP1380CDR2G
NCP1380BDR2G	UC3845BVD1R2G	UC3845BVD1G
UC3845BD1R2G	UC3845BD1G	UC3844BVD1R2G
UC3844BVD1G	UC3844BD1R2G	UC3844BD1G
UC3843BVD1R2G	UC3843BVD1G	

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

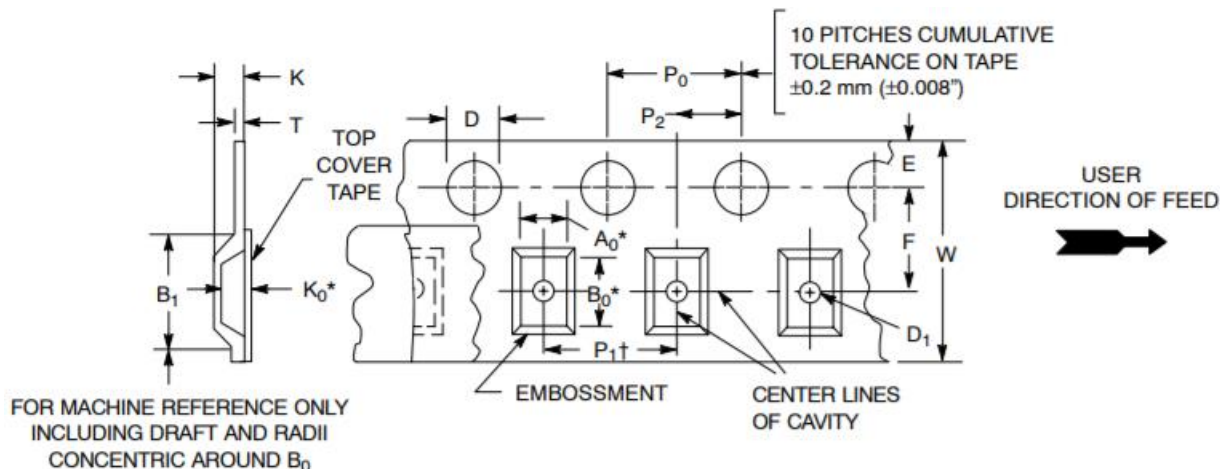
注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



変更件名:	ASEKS SOIC8L 製品キャリアテープ設計の変更	
発効日:	25 October 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Marquita.Jones@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	本製品速報は通知目的のみのものです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。	
変更カテゴリ:	テスト変更	
変更サブカテゴリ:	出荷/梱包/マーキング	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: ASEKS, China

説明および目的:

新規設計は、リールのポケット内での製品の移動を最小にすることを目的としています。リップ (フェンス) がポケット内に設けられて製品の動きを抑制します。バンダーの変更はなく、また最終リール収納数および梱包仕様にも変更はありません。



変更される材料	変更前の表記	変更後の表記
A0 サイズ	6.9 mm	6.55 mm
K0 サイズ	2.0 mm	2.1 mm
K1 サイズ	1.7 mm	1.8 mm
キャリアテープ設計		



影響を受ける部品の一覧:

注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールのお客様の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

LM258DR2G	LM2903DR2G	LM2903VDR2G
LM2904DR2G	LM2904VDR2G	LM293DR2G
UC3843BD1R2G	UC3843BD1G	UC3842BVD1R2G
UC3842BVD1G	UC3842BD1R2G	UC3842BD1G
UC2845BD1R2G	UC2845BD1G	UC2844BD1R2G
UC2843BD1R2G	UC2843BD1G	UC2842BD1R2G
UC2842BD1G	NCP1608BDR2G	NCP1607BDR2G
NCP1252EDR2G	NCP1252DDR2G	NCP1252CDR2G
NCP1252BDR2G	NCP1252ADR2G	NCL30000DR2G
LM393DR2G	LM358DR2G	NCP1611BDR2G
NCP1611ADR2G	NCP4303ADR2G	NCP1653DR2G
NCP1653ADR2G	NCP1230D65R2G	NCP1230D133R2G
NCP1230D100R2G	NCP1207ADR2G	NCP4304BDR2G
NCP4304ADR2G	NCP1380DDR2G	NCP1380CDR2G
NCP1380BDR2G	UC3845BVD1R2G	UC3845BVD1G
UC3845BD1R2G	UC3845BD1G	UC3844BVD1R2G
UC3844BVD1G	UC3844BD1R2G	UC3844BD1G
UC3843BVD1R2G	UC3843BVD1G	